

新應材股份有限公司
Advanced Echem Materials Company Ltd.

股票代號：4749

法人說明會

2026年11月

©Copyright AEMC

免責聲明

- 本公司對其現況的期待及預測是屬於前瞻性陳述的範疇，本身具有重大風險及不確定性，而致實際結果可能與前瞻性陳述內容有明顯差異。
- 本公司對於前瞻性陳述不作任何聲明或保證，除非法令另有要求外，本公司亦不因新資訊、未來事件或其他情事變更事由，負有主動更新前瞻性陳述的義務。

- AEMC’ s statements of its current expectations are forward-looking statements subject to significant risks and uncertainties and actual results may differ materially from those contained in the forward-looking statements.
- AEMC makes no representation or warranty regarding such forward-looking statements. Except as required by law, AEMC undertakes no obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

©Copyright AEMC

目錄

- 公司簡介
- 主要產品與市場規模
- 產品開發計畫
- 財務數據
- ESG永續實績
- 補充資料

©Copyright AEMC

公司簡介

實收資本額：NT$947,328千元
US$31.6 million
員工人數：495人 (2026.09)
研發人員：143人 (2026.09)

主要產品

半導體特化材料營收占比：92% (3Q 2026)
顯示器特化材料營收占比：8% (3Q 2026)

營運據點

桃園廠暨研發中心：研發中心、顯示器特化材料、半導體光學元件材料
台南廠：半導體特化材料
高雄廠P1、P2：半導體特化材料
龍科廠（建置中）：研發中心
美國子公司：Sales office
日本子公司：Sales office

©Copyright AEMC

公司簡介


顯示器面板光阻
2003
半導體光學元件材料
2014
半導體先進製程材料
2018
半導體先進製程光阻
2025
半導體先進封裝材料
2026

主要產品

半導體特化材料

-先進微影製程

- 表面改質劑(Rinse)
- 底部抗反射層(BARC)
- 洗邊劑(EBR)
- 清洗劑(Cleaner)

-先進封裝材料

-光學元件材料

- 影像感測器材料
- 微型光學元件材料

顯示器特化材料

-顯示器光阻劑

©Copyright AEMC

新應材的使命與願景

使命Mission

建立上下游供應鏈

建立台灣半導體先進製程特化材料自主技術，
並透過合作提升本土特化材料上、下游產業鏈的
全球競爭優勢。

願景Vision

擴大半導體材料品項及市佔率

持續精進合成、純化、配方和製程技術，
滿足客戶需求以協助提升良率，創造卓越的附加價值，
成為具全球競爭力的創新型特化材料企業。

重要肯定

- 2022年采鈺優良供應商獎
- 2022年台積公司優良供應商卓越表現獎-卓越黃光材料開發合作與量產支援
- 2023年經濟部國家產業創新獎
- 2026年行政院第28屆國家品質獎「全面卓越類-績優經營獎」

新應材策略佈局版圖

- 核心願景：滿足客戶需求以協助提升良率，創造卓越的附加價值，成為具全球競爭力的創新型特化材料企業。
- 以**材料科學**與**研發能力**為核心，聚焦高技術門檻、高進入障礙之產業，透過策略投資布局關鍵材料與技術，建立長期競爭優勢。

半導體前段製程材料

新應材
黃光微影特化材料
- 專長領域：合成、純化、配方

思微合成
策略性原料之研發
- 專長領域：合成
- 持股比例：70%

歐利得材料
策略性原料之生產製造
- 專長領域：合成
- 持股比例：普通股40%
  +特別股13.34%

富宸材料
半導體特殊氣體之研發製造
- 專長領域：純化
- 持股比例：15.74%

先進封裝材料

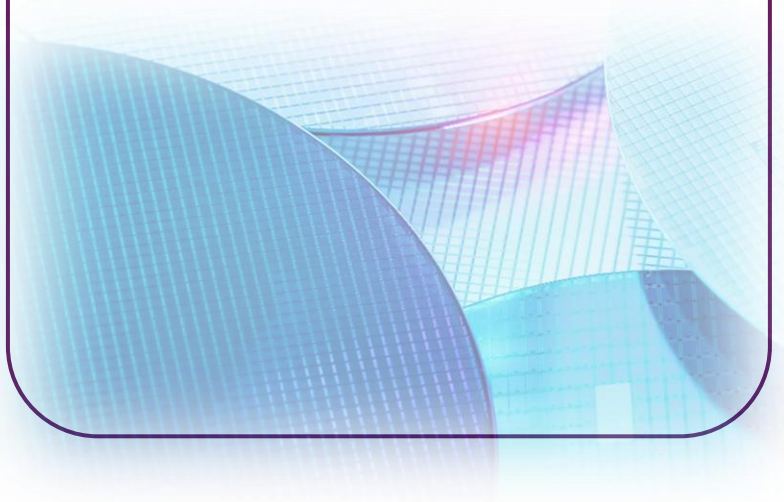
新應材
黃光微影特化材料
- 專長領域：合成、純化、配方

昱鐳應材
後段封裝及TGV材料
- 專長領域：合成、配方
- 持股比例：25.08%

新寶紘科技
LEAP先進封裝膠帶
- 專長領域：配方、塗佈
- 持股比例：25.75%

AI及CCL材料

昱鐳應材
HPC(AI、Server應用)、CCL膠
- 專長領域：合成、配方
- 持股比例：25.08%



©Copyright AEMC

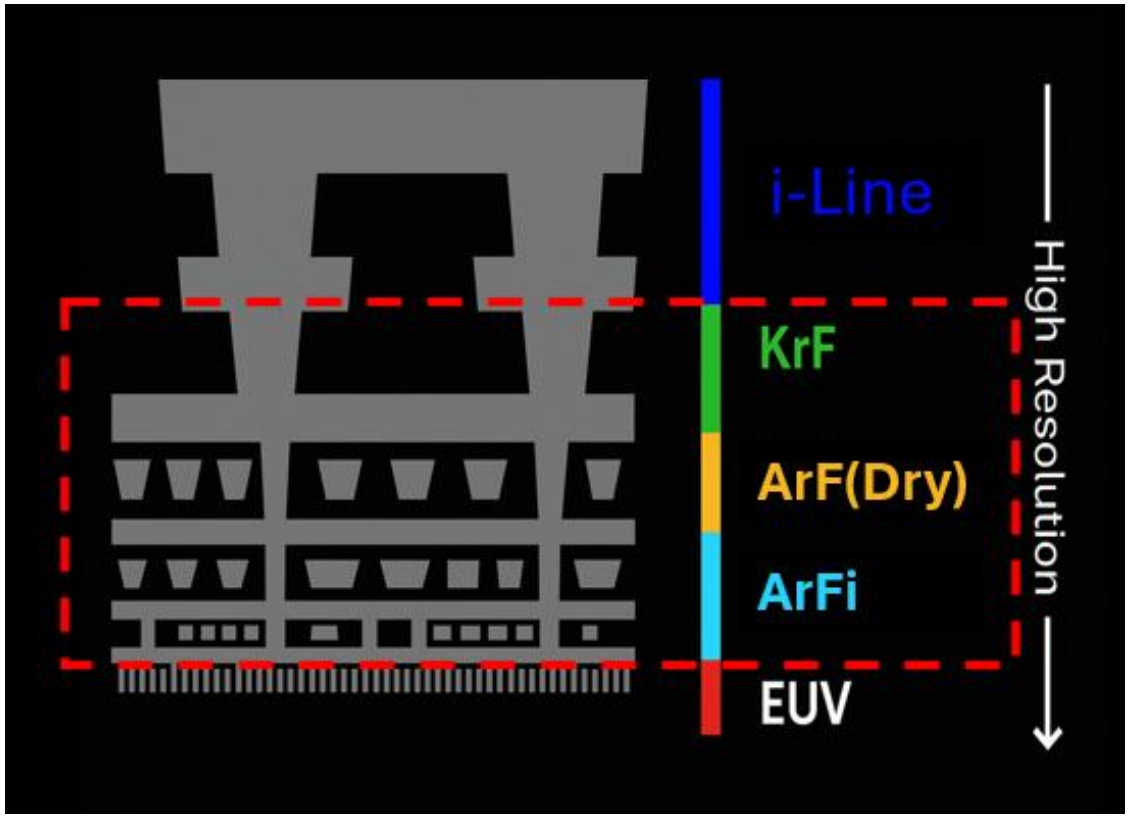
目錄

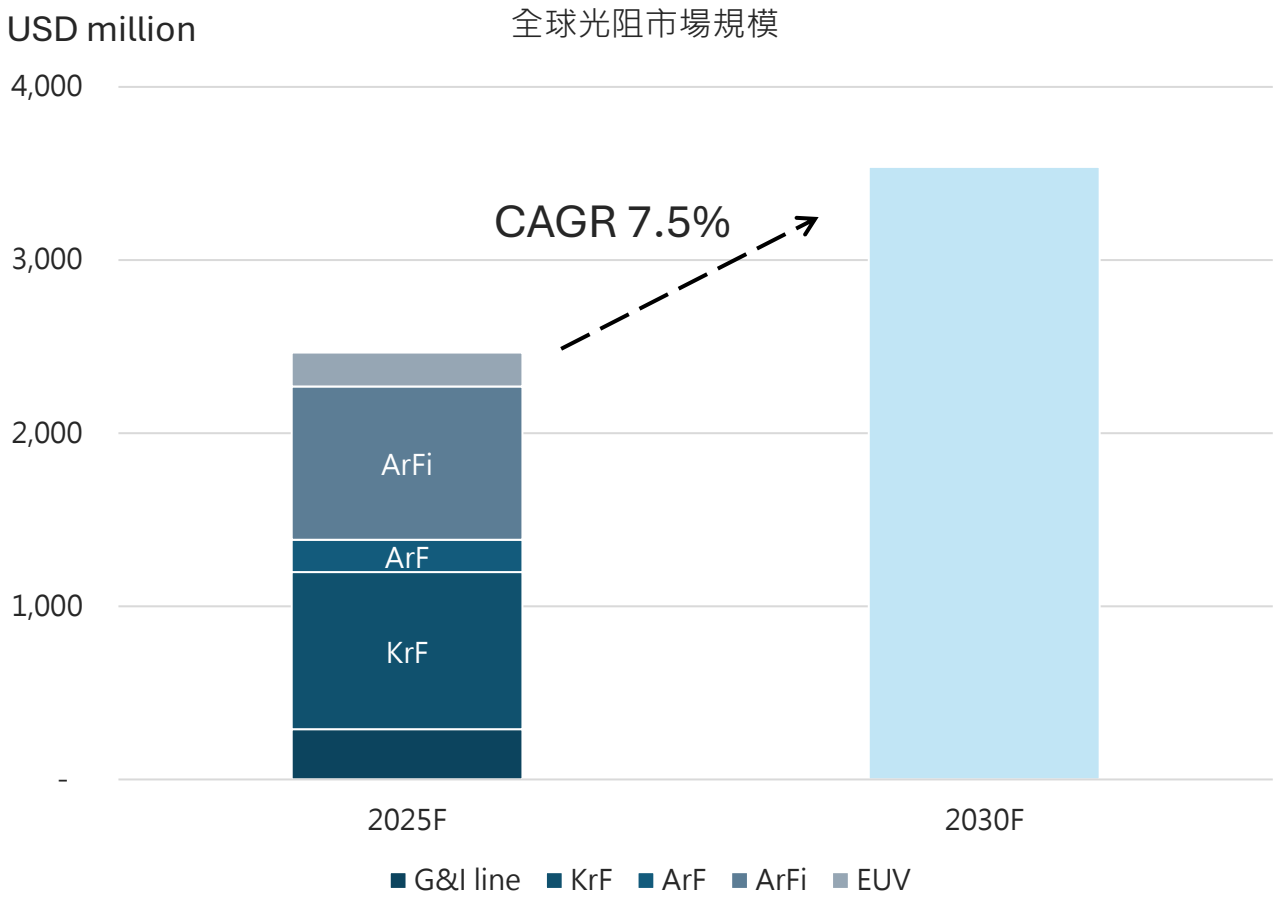
- 公司簡介
- 主要產品與市場規模
- 產品開發計畫
- 財務數據
- ESG永續實績
- 補充資料

產品開發計畫

Application Field	Mass Production	Verification	Developing
Advanced Microlithography Materials	• Rinse Material (表面改質劑) • BARC (底部抗反射層) • EBR (洗邊劑) • Cleaner (清洗劑)	• Rinse Material for next node • BARC for next node • EBR for next node • Cleaner for next node • DUV Photoresist (KrF)	• Bottom Layer for next node • Advanced BARC • Protection Layer • DUV Photoresist (ArF)
Advanced Packaging Materials	• Temporary Protection Layer • Plasma Dicing Glue	• Protection Layer for SoIC • KrF BARC • Cleaner • Protection Glue for CPO • Leveling Layer	• High AR Photoresist • Packaging Glue • Photoresist for Fine pitch QFN
Optical Element Materials	• Photoresists (光阻劑) • Flat Layer (平坦層) • Color Filter Layer (濾光層) • Light-cut Layer (遮光層) • Lift-off Layer(離型層)	• DUV Photoresist (ArF) • Stripper • Liff-off Layer for next node • ArF BARC • Adhesion Layer	• Leveling Layer • Microlens Materials

全球光阻市場規模





Source: TECHCET(2021)、WSTS(2024)、Deloitte(2025)、 Estimate by Company

目錄

- 公司簡介
- 主要產品與市場規模
- 產品開發計畫
- 財務數據
- ESG永續實績
- 補充資料

財務績效

單位:新台幣百萬元	3Q26	2Q26	3Q25	QOQ	YOY
營業收入淨額	**1,331**	**1,233**	**1,066**	**8.0%**	**24.9%**
營業毛利	633	549	450	15.3%	40.5%
營業毛利率	47.6%	44.5%	42.3%		
營業費用	288	263	191	9.5%	50.9%
營業淨利	345	286	259	20.7%	33.2%
營業淨利率	25.9%	23.2%	24.3%		
營業外收入及支出	277	75	77	270.3%	257.7%
歸屬予母公司業主之本期淨利	**551**	**304**	**290**	**81.1%**	**89.9%**
每股盈餘(新台幣元)	5.87	3.28	3.13	79.0%	87.5%

營收

YOY+24.9%

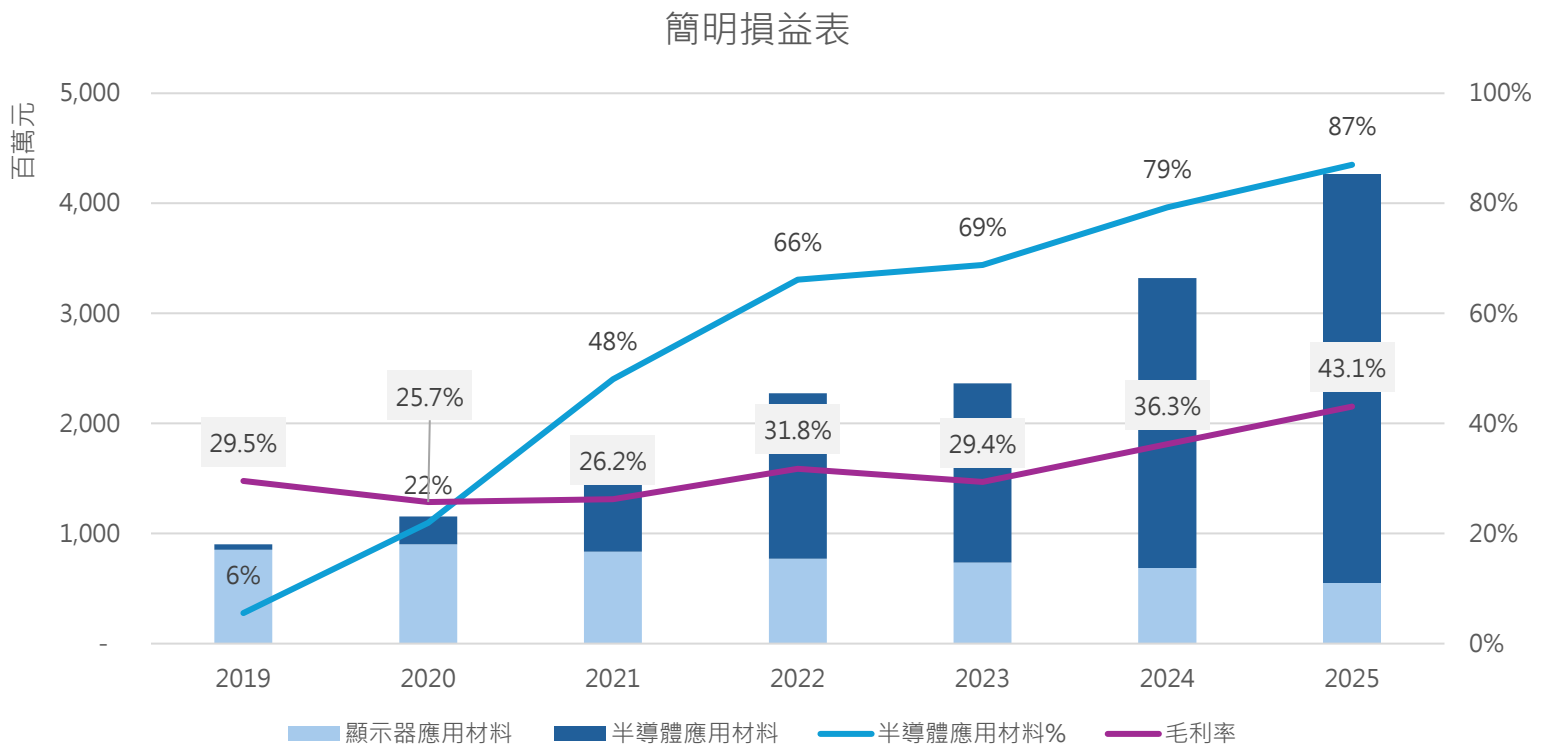
3Q 2026

歸屬母公司淨利

YOY+89.9%

3Q 2026

財務績效



半導體應用材料營收占比

92%

3Q 2026

半導體應用材料營收CAGR

48%

2021年~2025年

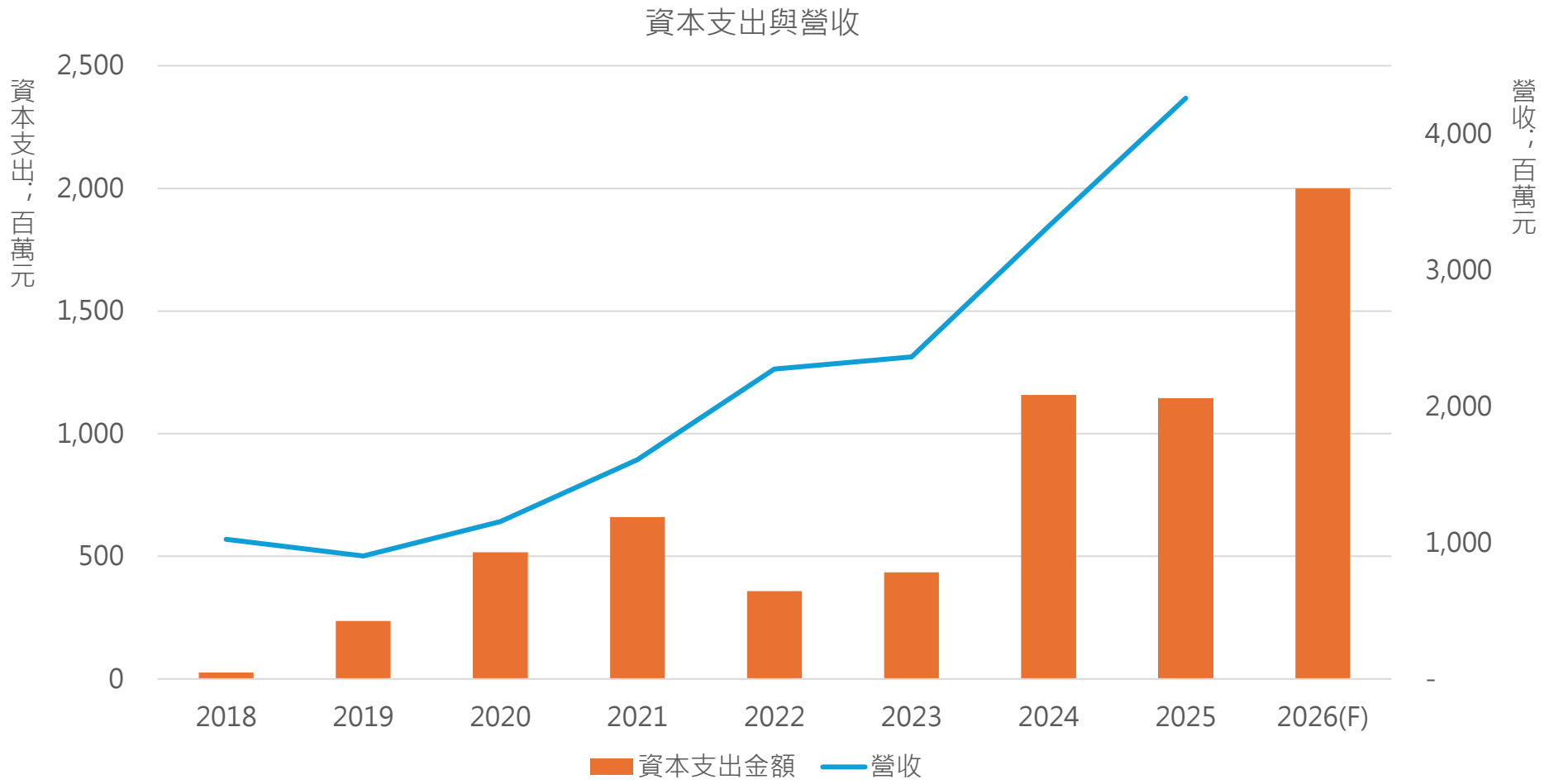
百萬元

年度	2021	2022	2023	2024	2025	1Q2026	2Q2026	3Q2026
營業收入	1,609	2,274	2,364	3,322	4,262	1,246	1,233	1,331
半導體應用材料	773	1,503	1,627	2,634	3,708	1,108	1,110	1,227
顯示器應用材料	836	771	737	688	554	138	123	103

©Copyright AEMC

資本支出與研發費用

自2018年轉型半導體材料開發，累計至2025年資本支出投入已超過 40 億元



ESG永續實績

社會參與



結合企業倡議與員工投入響應，持續深化公益及環境永續行動

節能減碳


bsi.

Opinion Statement

Greenhouse Gas Emissions

Verification Opinion Statement

making excellence a habit.

較法規時程提前完成溫室氣體盤查，2024、2025年取得第三方查證機構核發聲明書

人才永續



成立「新應材獎學金」培育材料專才、成立「新住民子女獎助學金」栽培多元人才、積極參與「產學合作」，為半導體產業發展恪盡責任

公司治理



4席獨立董事，占比>44%
2席女性董事，占比>22%

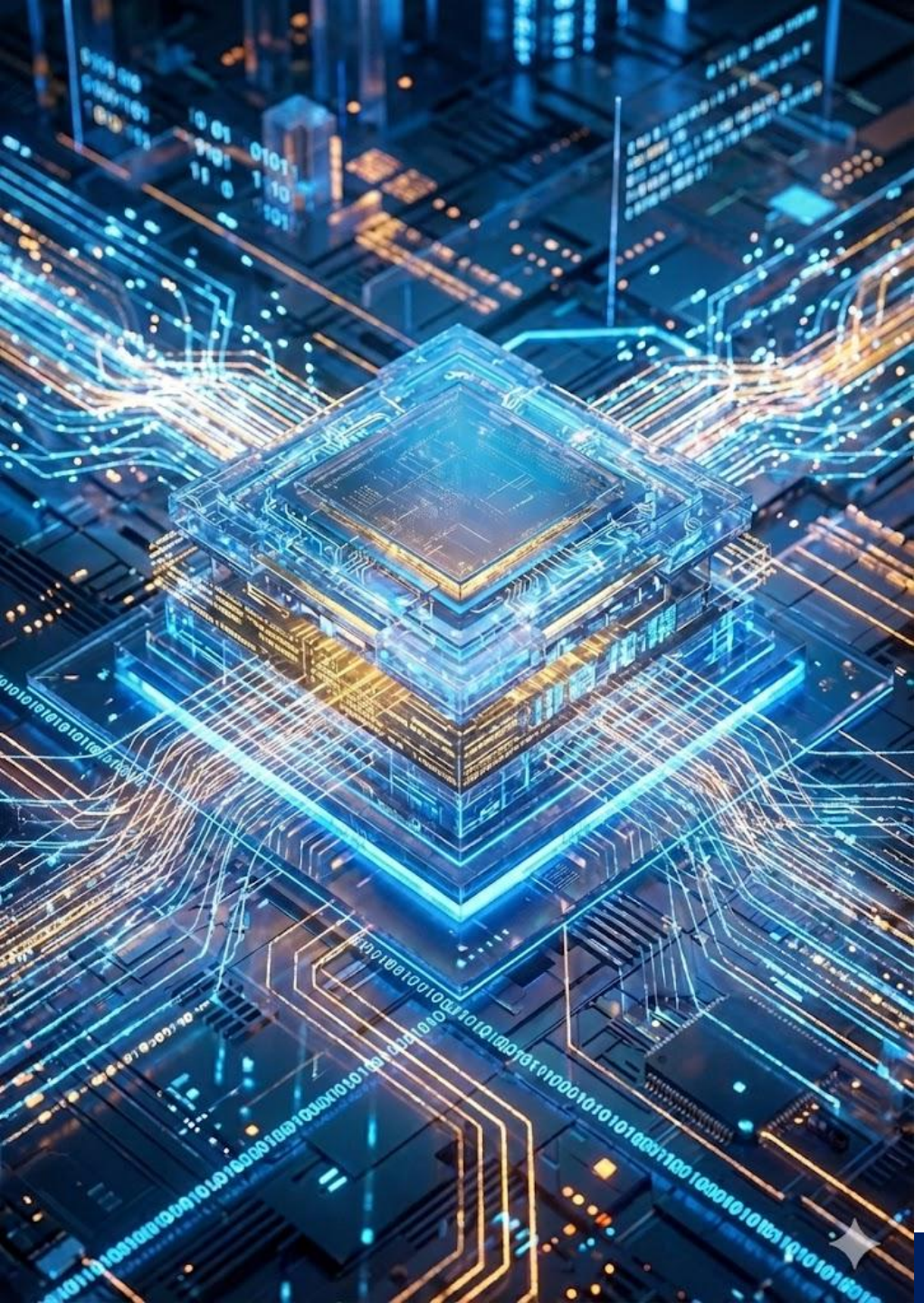
2025年初次發行永續報告書，每年定期發行

友善職場



連續3年榮獲幸福企業金獎的肯定

公司重視性別平權與多元發展，女性員工及女性主管占比皆超過30%



意見交流

謝謝聆聽

For further information, please visit our website at:
https://www.aemc.com.tw/

Contact Investor Relations at:
ir@aemc.com.tw

©Copyright AEMC

損益表

單位:新台幣百萬元	3Q26	2Q26	3Q25	QOQ	YOY
營業收入淨額	**1,331**	**1,233**	**1,066**	**8.0%**	**24.9%**
營業毛利	633	549	450	15.3%	40.5%
營業毛利率	47.6%	44.5%	42.3%		
營業費用	288	263	191	9.5%	50.9%
營業淨利	345	286	259	20.7%	33.2%
營業淨利率	25.9%	23.2%	24.3%		
營業外收入及支出	277	75	77	270.3%	257.7%
歸屬予母公司業主之本期淨利	**551**	**304**	**290**	**81.1%**	**89.9%**
每股盈餘(新台幣元)	5.87	3.28	3.13	79.0%	87.5%

©Copyright AEMC

資產負債表

單位:新台幣百萬元	3Q26		2Q26		3Q25	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	2,086	12.9%	1,887	13.0%	1,286	12.8%
應收帳款	598	3.7%	684	4.7%	552	5.5%
不動產、廠房及設備	4,610	28.5%	4,546	31.2%	3,120	31.0%
資產總計	**16,180**	**100.0%**	**14,569**	**100.0%**	**10,071**	**100.0%**
流動負債	1,319	8.2%	1,791	12.3%	1,018	10.1%
長期借款	300	1.9%	300	2.1%	-	0.0%
負債總計	**3,751**	**23.2%**	**4,212**	**28.9%**	**1,172**	**11.6%**
股東權益總計	**12,429**	**76.8%**	**10,349**	**71.0%**	**8,899**	**88.4%**
重要財務指標						
流動比率	708%		445%		606%	
負債比率	23%		29%		12%	
每股淨值(新台幣元)	131.11		111.49		95.96	

©Copyright AEMC

現金流量表

單位:新台幣百萬元	3Q26	2Q26	3Q25
期初現金	**1,887**	**893**	**2,569**
營運活動之現金流入	363	217	158
折舊及攤銷費用	79	78	65
資本支出	(189)	(748)	(124)
長期借款	0	300	(974)
期末現金	**2,086**	**1,887**	**1,778**
自由現金流量	174	(531)	34

註:自由現金流量= 營運活動之現金流入-資本支出

©Copyright AEMC

目錄

- 公司簡介
- 主要產品與市場規模
- 產品開發計畫
- 財務數據
- ESG永續實績
- 補充資料

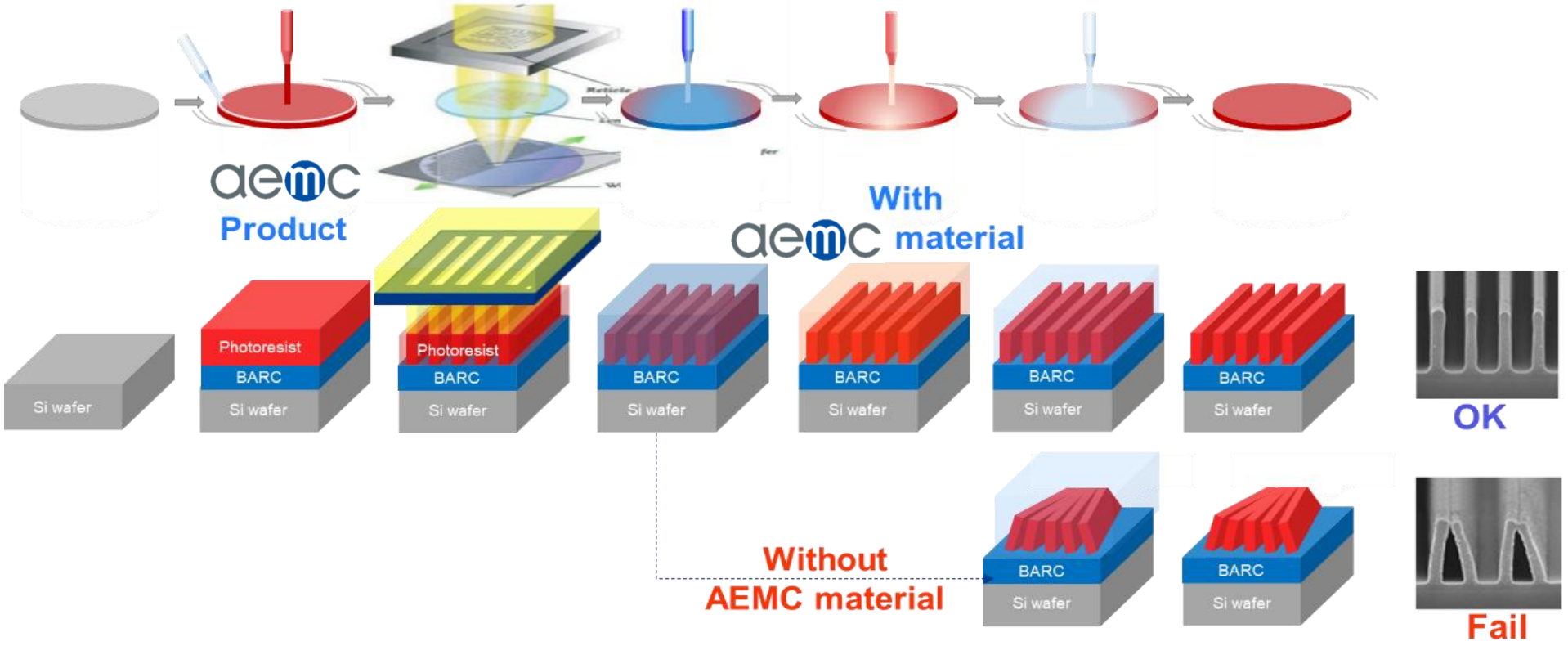
半導體先進微影製程材料

aemc 產品

- 抗反射劑BARC
- 洗邊劑EBR

- 表面改質劑 Rinse Material

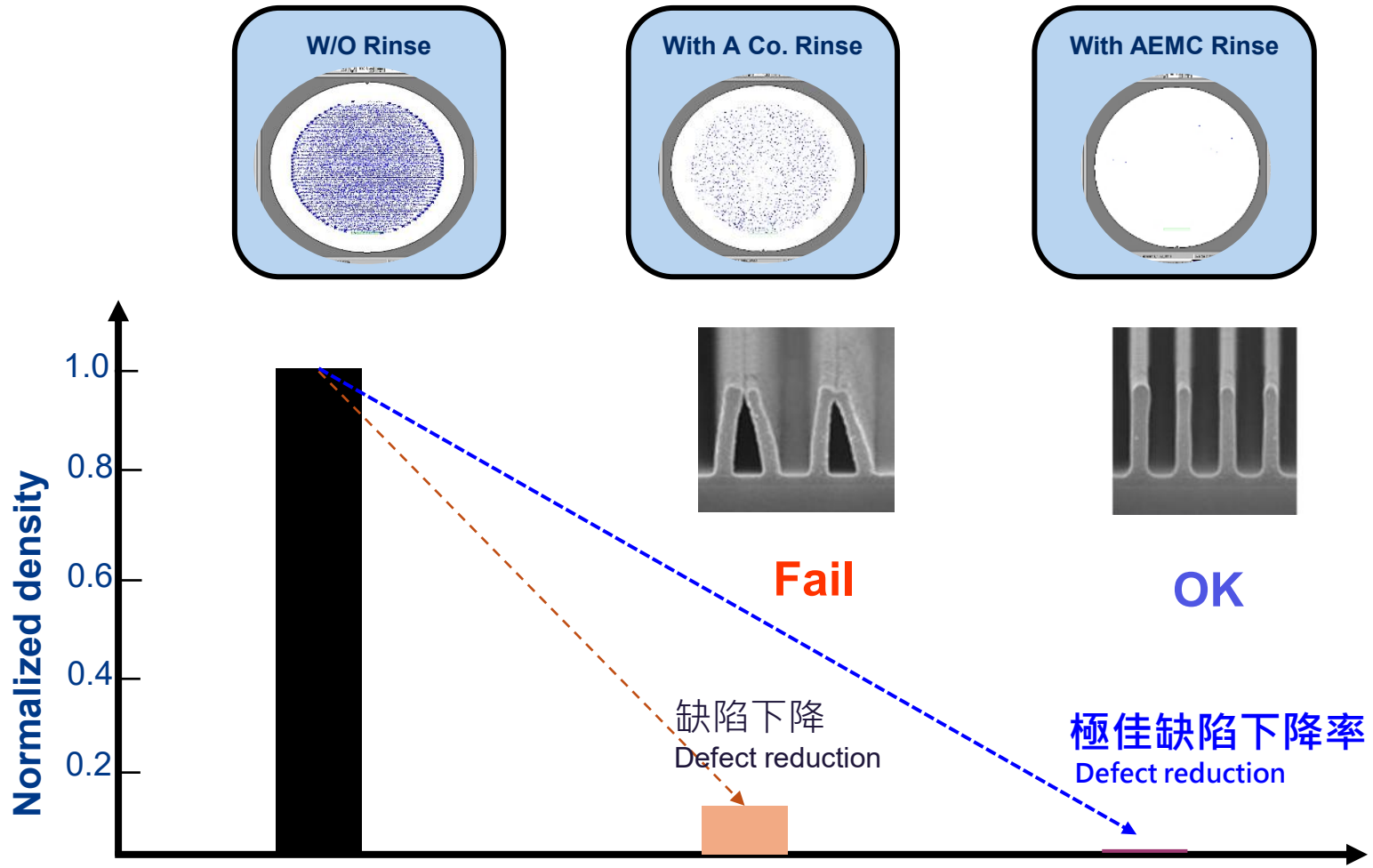
- 清洗劑Cleaner (管路、設備)



矽晶圓 Si wafer | 塗佈 Coating | 曝光 Exposure | 顯影 Development | 表面改質 Rinse material treatment | 乾燥 Spin dry

半導體先進製程良率之關鍵材料：Rinse表面改質劑

Defect缺陷對比： 新應材 Rinse材料性能世界No.1



效益 Benefits

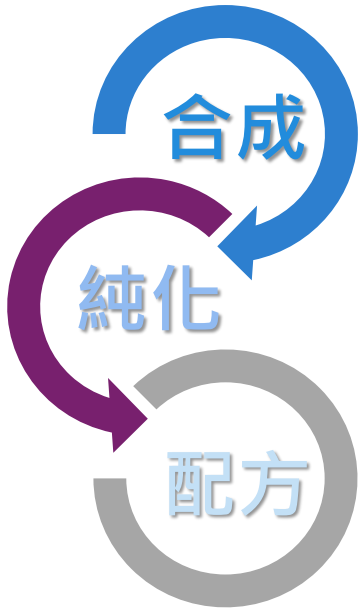
√ 製程簡單 Straightforward process

√ 降低圖案缺陷 Pattern collapse mitigation

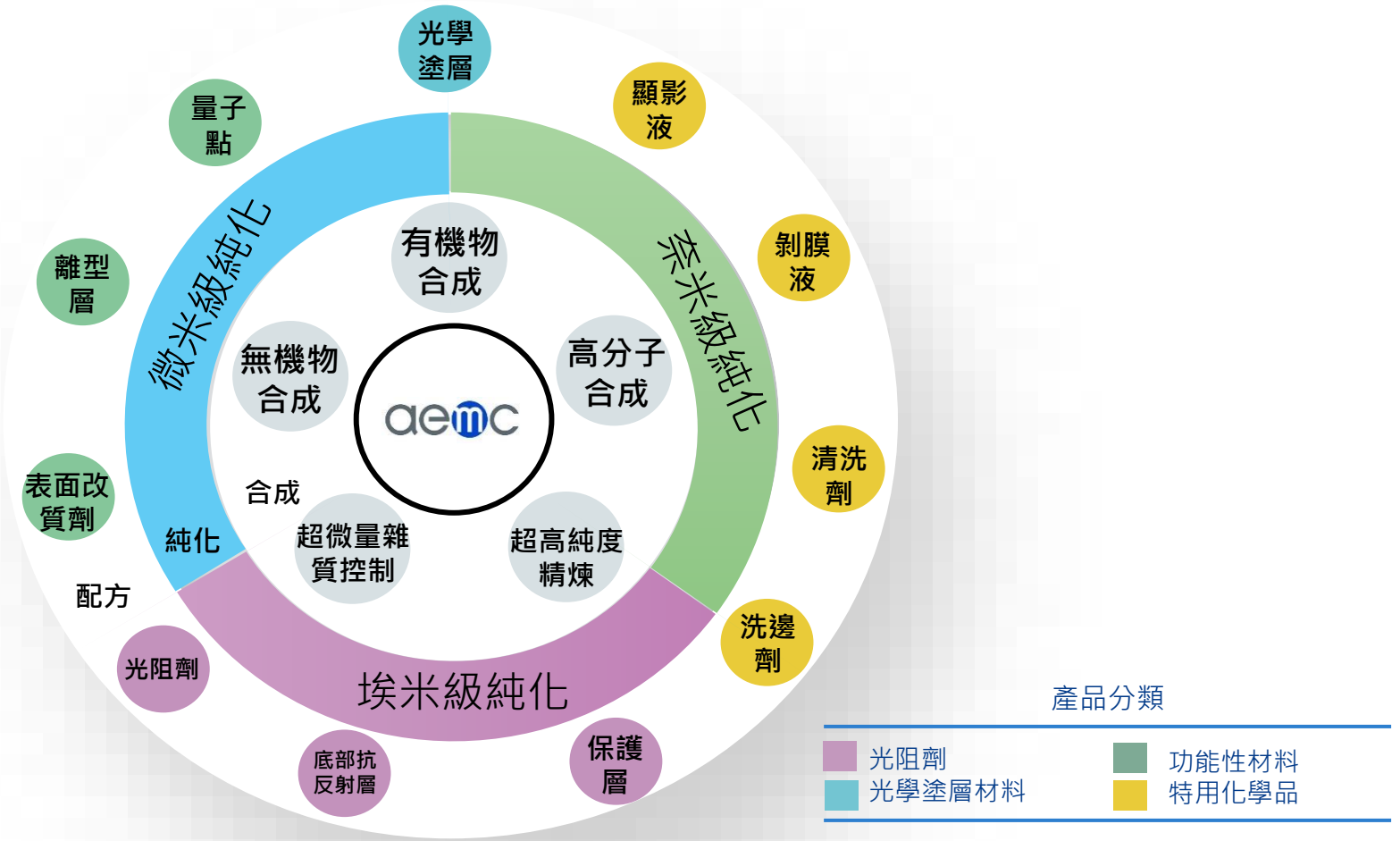
√ 降低缺陷 Defect reduction

©Copyright AEMC

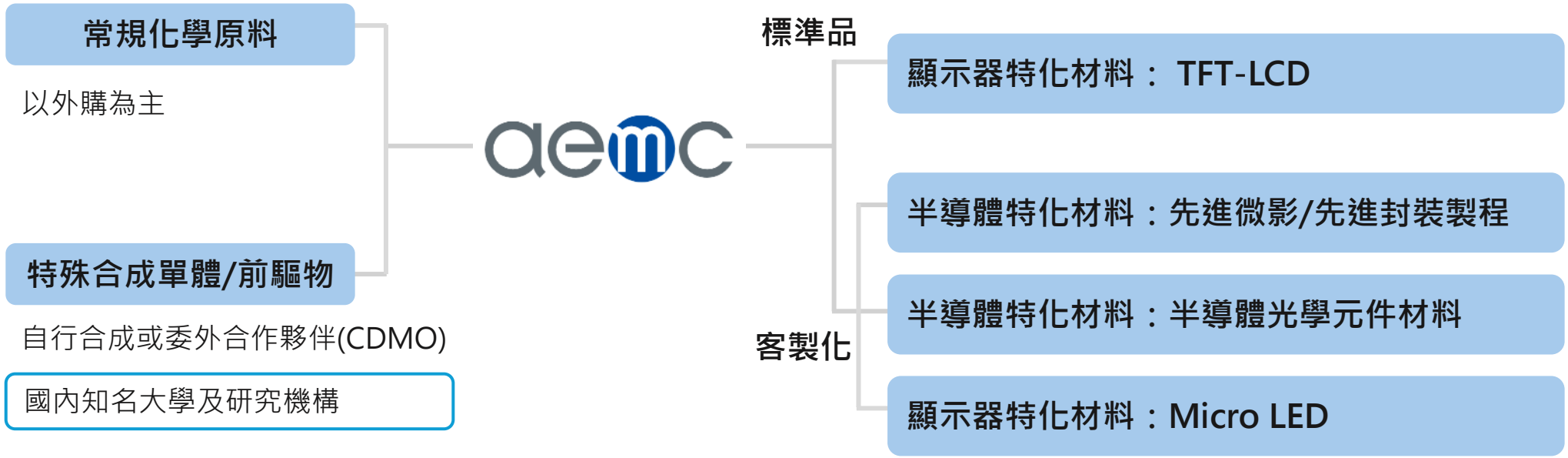
競爭優勢一、從配方開發向上整合自建原料合成能力



近20年材料/數千種材料配方資料庫



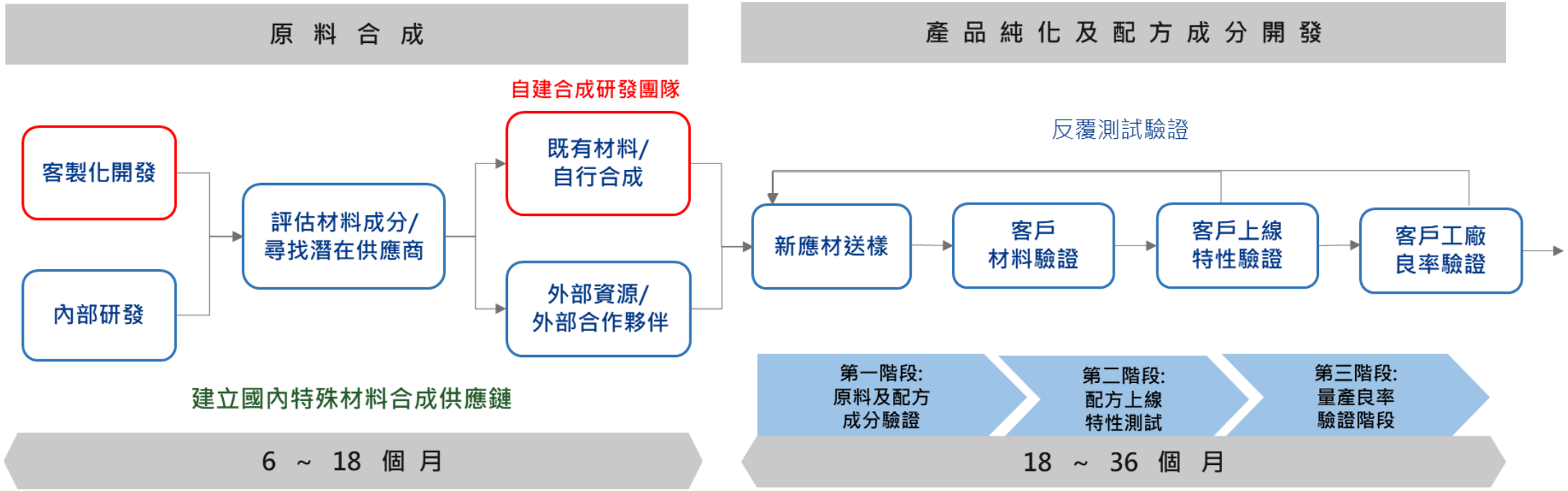
競爭優勢二、建立本土材料供應鏈的策略聯盟



©Copyright AEMC

競爭優勢三、快速回應及高學習曲線

客製化開發之回應速度及送樣頻率
遠高於國外大廠



©Copyright AEMC

競爭優勢四、優異的品質控管及自主設計的製程技術

優異的品質控管

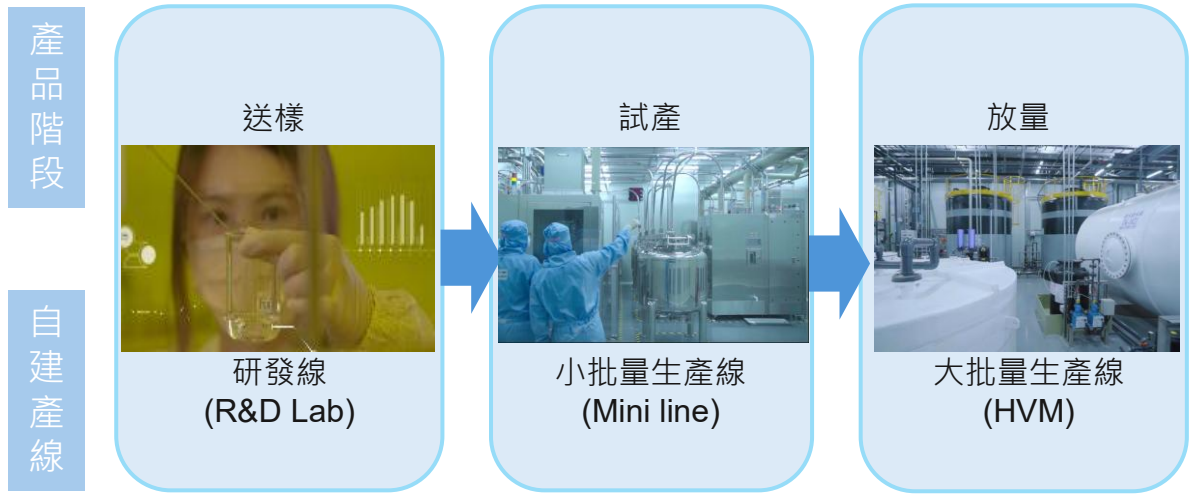
✓ **品質控管設備與系統:**

1. 建置與客戶同等級設備

2. 符合半導體最先進製程需求之超微量雜質控管: 由 ppb (10^{-9}) 進化到 ppt (10^{-12})等級

3. 智能品質監控系統: 自動化產品檢測與品質數據整合分析

自主設計的製程技術



國內外同業產品比較

量產品V 驗證中O

微影製程材料		aemc	B*	M*	J*	S*	F*	T*	S*	N*	Q*
		台灣	德國	德國	日本	日本	日本	日本	日本	日本	美國
光阻	CIS	V					V				
	G/I-line	V		V	V	V	V	V	V		
	KrF	O		V	V	V	V	V	V		V
	ArF	O		V	V	V	V	V	V		V
	EUV				V	V		V	V		
週邊材料	抗反射劑 (BARC)	V								V	V
	表面改質劑 (Rinse)	V		V							
	清洗劑 (Cleaner)	V	V								
	顯影劑 (Developer)	V						V			
	洗邊劑 (EBR)	V	V	V	V			V			
	絕緣層材料	O								V	

註:兆豐證券整理，彙整自公司官網及公開資訊等。上述材料聚焦於半導體前段製程。

©Copyright AEMC